

STWJ誌との提携により、本会よりSTWJ誌へ推薦された論文は次のとおりです。

1. 「出力変調溶接によるポロシティの抑制
-大出力CO₂レーザ溶接におけるポロシティ抑制に関する研究(第3報)-」
川口 勲*, 塚本 進**, 荒金 吾郎**,
中田 一博***
*物質・材料研究機構(現・(株)IHI)
**物質・材料研究機構
***大阪大学
(論文集25巻2号)
2. 「接合自己完了型摩擦圧接法の開発」
木村 真晃*, 藤井 利充*, 内海 大輔*,
日下 正広*, 瀬尾 健二*
*兵庫県立大学
(論文集25巻2号)
3. 「スイッチバック溶接による溶接溶融池の数値シミュレーション」
金子 裕良*, 前川 康之*, 山根 敏*,
大嶋 健司*
*埼玉大学
(論文集25巻2号)
4. 「高出力ファイバーレーザによるステンレス鋼溶接時のレーザ誘起ブルームの高速度観察および分光分析」
川人 洋介*, 木下 圭介*, 松本 直幸*,
水谷 正海*, 片山 聖二*
*大阪大学
(論文集25巻3号)
5. 「鋼溶接金属におけるアシキュラーフェライト生成に関与する介在物の微視的観察」
山田 知典*, 寺崎 秀紀*, 小溝 裕一*
*大阪大学
(論文集25巻3号)
6. 「金ろうを用いた高強度ステンレス鋼レーザーろう付部の高温割れ」
才田 一幸*, 阪谷 岳洋**, 宋 宇鉉***,
西本 和俊*
*大阪大学
**大阪大学(現 三菱重工業(株))
***大阪大学(現 POSCO)
(論文集25巻3号)

7. 「数値計算シミュレーションによるガスタングステン
アーク溶接の金属蒸気挙動解析」
山本健太郎*, 田中 学*, 田代 真一*,
中田 一博*, 山崎 圭**, 山本 恵理**,
鈴木 啓一**
*大阪大学
**(株)神戸製鋼所
(論文集25巻3号)
8. 「超高パワー密度ファイバーレーザによるステンレス
鋼溶接時のレーザと誘起プラズマ/ブルームとの相
互作用」
川人 洋介*, 木下 圭介*, 松本 直幸*,
水谷 正海*, 片山 聖二*
*大阪大学
(論文集25巻3号)
9. 「高周波パルスを用いた低スパッタCO₂アーク溶接技
術の開発」
片岡 時彦*, 池田 倫正*, 安田 功一*,
平田 好則**
*JFEスチール(株)
**大阪大学
(論文集25巻4号)
10. 「摩擦攪拌点接合で得られた6061 アルミニウム合金
攪拌領域の組織学的検討」
藤本 光生*, 古賀 信次*, 阿倍奈津美**,
佐藤 裕**, 粉川 博之**
*川崎重工業(株)
**東北大学
(論文集25巻4号)
11. 「熱間工具鋼の溶接凝固過程に及ぼす凝固速度の影
響」
橋本 匡史*, 寺崎 秀紀*, 小溝 裕一*
*大阪大学
(論文集25巻4号)
12. 「炭酸ガスアーク現象に及ぼすワイヤへのREM添加の
影響」
片岡 時彦*, 池田 倫正*, 小野 守章*,
安田 功一*, 平田 好則**
*JFEスチール(株)
**大阪大学
(論文集26巻1号)



Mate 2009 第15回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」 シンポジウム参加者募集

主催：(社)溶接学会 マイクロ接合研究委員会
共催：(社)機械学会 エレクトロニクス実装における信頼性設計と熱制御に関する研究分科会, (社)高温学会 微細加工研究情報委員会, (社)日本塑性加工学会 接合・複合分科会, (社)日本電気制御機器工業会, エレクトロニクス生産科学学会準備会, レーザ加工学会, 大阪大学 先端科学イノベーションセンター
協賛：映像情報メディア学会, エレクトロニクス実装学会, 応用物理学会, 化学工学会, 画像電子学会, 軽金属学会, 計測自動制御学会, 高温学会, 高分子学会, 資源・素材学会, システム制御情報学会, 情報処理学会, 精密工学会, 電気化学会, 電気学会, 電気設備学会, 電子情報通信学会, 日本機械学会, 日本金属学会, 日本顕微鏡学会, 日本材料学会, 日本シミュレーション学会, 日本接着学会, 日本セラミックス協会, 日本塑性加工学会, 日本伝熱学会, 日本非破壊検査協会, 日本表面科学学会, 日本品質管理学会, 日本複合材料学会, 日本物理学会, 日本分析化学学会, 日本溶接協会, 表面技術協会, プラスチック成形加工学会

開催趣旨

日本のエレクトロニクス産業は、この20年間、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた新たな電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下、日本の高度成長を牽引してきました。今後も日本が世界を先導し続けるには、生産技術を科学的に探求することはもちろんのこと、既存の学問領域、設計・生産技術などの領域を越えて、エレクトロニクスを取巻く科学技術、経営・生産システム、価値システム、などの広い範囲を取り込んだグローバルなオプティマイゼーションとそれに基づくシステムインテグレーションが不可欠になってきています。本シンポジウムでは、これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。

日時：平成21年1月29日(木) 8:50～17:50
平成21年1月30日(金) 9:00～17:30

会場：パシフィコ横浜 アネックスホール
(F201～F206)
横浜市西区みなとみらい1丁目1-1

シンポジウム参加登録費(論文集代を含む)

○主催・共催団体登録会社 : 20,000円
 ○協賛学協会会員会社 : 30,000円
 ○論文口頭発表者 : 15,000円

○大学、国公立研究機関 : 10,000円
 ○学生 : 5,000円
 ○その他(一般) : 40,000円

シンポジウム参加申込方法

下記シンポジウムURLより平成21年1月20日(火)までに参加登録を行って下さい。

<http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/mate/Mate2009.html>

参加費のお支払いは、銀行振込・クレジットカードのいずれかをお願い致します。

問合せ、申込先 Mate 2009 事務局 事務代行
 <参加申込>

株式会社 日本旅行
 イベント・コンベンション営業部
 TEL: 03-5565-9890, FAX: 03-5565-9611
 E-Mail: mcs_inq01@nta.co.jp

<論文および広告・カタログ>

合同会社フロンティア・アライアンス
 ものづくりリエゾンオフィス事業部
 TEL: 06-6878-5628, FAX: 06-6879-7568
 E-Mail: mate@fa-mlo.com

参加申込締切日：平成21年1月20日(火)

振込先銀行：みずほコーポレート銀行 十五号支店
 口座番号：普通3101980
 口座名：株式会社日本旅行

シンポジウム URL

<http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/mate/Mate2009.html>

プログラム(セッション名と発表件数)

1月29日(木) 8:50～17:50 (18:00～懇親会)

◆プレナリーセッション

「イノベーション創出の鍵を握るシステムデザイン・インテグレーション(SD・SI)と課題」

(大阪大学 佐藤了平)

「ものづくりデジタルデザインの現状と新SD・SI手法開発状況及び今後の展開」

((株)エンジニアスジャパン 工藤啓治
 大阪大学 岩田剛治)

「エレクトロニクスシステムの鍵を握る半導体の微細化限界と3次元システムLSIの可能性と最前線」

((株)ニコン 岡本和也)

「次世代半導体の鍵を握るSipの現状と今後の展開」

((株)ルネサステクノロジ 赤沢 隆)

1月29日（木） 8:50～17:50

- [A-1] めっき・信頼性（4件）
- [A-2] 接続信頼性 I（4件）
- [A-3] 接続信頼性 II（5件）
- [B-1] フィラー実装（5件）
- [B-2] 材料・デバイス開発（4件）
- [B-3] 薄膜・レーザ加工（4件）

1月30日（金） 9:00～17:30

- [A-4] パワーモジュール（6件）
 - [A-5] 熱変形（4件）
 - [A-6] 力学信頼性（5件）
 - [A-7] 疲労・熱疲労（4件）
 - [B-4] MEMS- I（講演2件+論文2件）
 - [B-5] MEMS- II（講演1件+論文3件）
 - [B-6] MEMS- III（5件）
 - [B-7] MEMS- IV（4件）
 - [C-4] 材料・界面反応（6件）
 - [C-5] 固相接合（5件）
 - [C-6] エロージョン I（講演2件+論文2件）
 - [C-7] エロージョン II（3件）
- （一般論文発表合計75件）



Best Author 賞(JWS Best Author Award)の推薦について

下記により Best Author 賞の推薦を募集いたします。

本年第1号(1月号)から第8号(12月号)までに会誌に掲載された記事の中から優秀と認められるものを、巻号、題名、著者、推薦理由を記して、1編、編集委員会宛て推薦下さい。

【賞の概要】

会誌「溶接学会誌」に発表された記事のうち、特に多数の会員の研鑽、及び、学術、技術の向上、普及に貢献した記事の著者に授与される。

【選考委員】

同賞選定委員会

委員長：会誌編集委員長

委員：編集委員より数名(各分野代表+総合企画+副委

員長)

【選考方法】

会誌編集委員および会員モニタの推薦による記事の中から選定委員会で選定する。

【選考基準】

溶接学会誌の本年第1号(1月号)から第8号(12月号)までに掲載された記事の中から、優秀と認められるものを、原則として毎年数編以内選定する。

【表彰等】

4月通常総会席上で表彰、賞状の贈呈。

【推薦書送付先】

(社)溶接学会 編集委員会宛



WEB掲載の溶接学会論文集26巻(平成20年度)の印刷物の購入について

溶接学会論文集は、平成19年1月より印刷物での発刊に代わってホームページ上にてWEB版として発刊されております。

印刷物にて一年分を纏めたものを購入される方は、下記により、平成21年3月31日までにお申込み下さいますようお願いいたします。

溶接学会論文集26巻(平成20年度)

【価格】 15,000円/年1冊(税込・送料別)

【申込先】 「お名前(会社名)」「送付先住所」「冊数」
をご明記の上、FAXにてお申込み下さい。

日本印刷出版株式会社 TEL: 06-6441-0075

FAX: 06-6443-5815



アドホック研究会「FSWの品質保証に関する研究会」委員公募

アドホック研究会の課題として「FSWの品質保証に関する研究会」を提案し、承認を得ました。

課題趣旨は下記致しましたように、FSWの接合部の品質保証法を確立することを目的とし、新たな技術開発を進めるための現状把握から開始していきたく思っております。

本課題にご賛同を戴き、特別研究会へのご参加をお願い申し上げます。

豊橋技術科学大学 安井利明
三重大学 川上博士

1. 背景と目的：

【設立の背景】

FSWは、非溶融の固相接合の利点を生かし、アルミの接合法として既に広く実用化されている。しかしながら、FSWにおける接合部は特異であり、まだその接合部の品質保証法は確立されていない。FSWを真に有用な技術とするためには、非破壊検査法をはじめとする新たな技術開発が必要である。

【目的】

本研究会では、FSWにおける以下の技術の中から複数を選び、現状把握を行うとともにそのための新たな技術開発を目的とする。

- (1) FSWのための非破壊検査法の確立
深さ200 μ m、幅数 μ mの接合不良部の検出
異材接合界面の接合欠陥の検出
- (2) FSWにおける塑性流動状態の観測
FSW用接合材および接合ツール開発のための塑性流動状態の観測
異材接合における特異な塑性流動状態の観測
- (3) FSW接合体における後熱処理の影響
FSW部のろう付(600 $^{\circ}$ C)後の超粗大粒
加熱による異材接合界面の金属間化合物層の成長
- (4) FSWによる異材接合の接合界面反応
異材接合界面に生成される金属間化合物の生成機構
- (5) FSW接合体の疲労特性評価方法の確立
剛性の異なる異材界面での応力集中状態の評価

2. 研究期間：平成20年10月1日～平成21年9月30日
(予定)

3. 参加申込・問い合わせ先：

三重大学大学院工学研究科機械工学専攻
川上博士
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
Tel：059-231-9474
e-mail：kawakami@mach.mie-u.ac.jp

岩手大学工学部材料物性工学科准教授の公募について

1. 公募人員：准教授 1名
2. 専門分野：
材料加工学の中で、鑄造・凝固工学分野，溶接・接合工学分野または粉末冶金分野における基礎及び応用に関する実験的研究．材料物性工学科の一員として教育・研究を担当
3. 着任時期：2009年4月1日以降
4. 任 期：な し
5. 応募資格：博士の学位を有し，教育・研究ともに熱意のある方
6. 担当科目：
○大学院 計測・分析技術特論，溶解技術実習，検査分析実習
○学 部 統計熱力学，材料計測学，学生実験
7. 提出書類：
 - 1) 履歴書（写真添付）
 - 2) 研究業績リスト（原著論文，総説・解説，著書，特許，国際会議プロシーディングス，その他）
 - 3) 主要論文別刷り（5編を添付のこと，コピー可）
 - 4) これまでの研究活動の概要（2000字程度）
 - 5) 教育業績（担当科目など），学会活動，社会貢献などの一覧
 - 6) 科研費などの外部資金の獲得状況
 - 7) 今後の研究計画と教育に関する抱負（2000字程度）
 - 8) 意見を求め得る方2名の氏名，連絡先（住所，電話，メールアドレス）
8. 公募締切：2008年12月26日（金）必着
9. 書類送付先：〒020-8551 岩手県盛岡市上田4-3-5
岩手大学工学部材料物性工学科
教 授 中村 満
10. 問合わせ先：
同上 中村 満（TEL・FAX：019-621-6370）
E-mail：weldpm@iwate-u.ac.jp
11. その他：封筒に「材料物性工学科准教授応募書類在中」と朱書き，簡易書留で送付のこと